

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

关于本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》 第11.2条、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二 十条和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》 第八条规定的说明

芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟发行股份及支付现金购买绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市远致一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）等 15 名交易对方合计持有的芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司（以下简称“标的公司”）72.33% 股权（以下简称“本次交易”）。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条的规定，科创板上市公司实施发行股份购买资产的，标的资产应当符合科创板定位，所属行业应当与科创公司处于同行业或者上下游，标的资产应当与上市公司主营业务具有协同效应，有利于促进主营业务整合升级和提高上市公司持续经营能力。

公司董事会经审慎判断，本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条的相关规定，具体如下：

一、标的公司符合科创板定位

标的公司主要从事功率半导体等领域的晶圆代工业务，主营产品包括 SiC MOSFET、IGBT 和硅基 MOSFET 等产品。按照《国民经济行业分类和代码表》GB/T 4754—2017 中的行业分类，标的公司属于“电子器件制造业”中的“半导体分立器件制造”（C3972）。按照《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》中的行业分类，标的公司属于“计算机、通信和其他电子设备制造业（CH39）”中的“电子器件制造（CH397）”。标的公司为国家发改委颁布的《产业结构调整

指导目录(2024年本)》规定的鼓励类产业;根据《战略性新兴产业分类(2018)》,标的公司所处行业为“1.2.1 新型电子元器件及设备制造”。因此,标的公司属于《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第五条中的“(一) 新一代信息技术领域”之“半导体和集成电路”,符合科创板行业领域。

二、上市公司与标的公司属于同行业

标的公司系为提升上市公司的制造工艺及扩充产能而设立,其主营业务、产品服务构成、核心技术、生产制造工艺、下游应用领域、客户供应商等方面基本与上市公司相同,在上市公司现有技术和产品线基础上通过研发迭代,进一步提升技术能力和生产能力。因此,标的公司与上市公司处于同行业。

三、标的公司与上市公司主营业务的协同效应

本次交易有利于上市公司获取主营业务所需的关键技术,并加速产品迭代。标的公司除布局一条月产7万片8英寸硅基晶圆生产线外,还前瞻性战略布局了SiC MOSFET、VCSEL(GaAs)和高压模拟IC等业务。

1、8英寸硅基晶圆形成规模效应,有利于降低成本,提升盈利能力

本次交易完成后,公司已有的月产10万片8英寸硅基晶圆生产线将与芯联越州的月产7万片8英寸硅基晶圆生产线合并,进行一体化管理,总产能达到月产17万片。一体化管理后,在采购管理方面,上市公司可将标的公司目前相对独立的采购部门纳入统一管理,发挥采购规模效应,提升议价能力;在库存管理方面,上市公司可整体降低原材料等采购备货,降低库存成本;在资金方面,可实现资金统一调配,减少单体流动资金储备。

2、SiC MOSFET形成协同效应,有利于公司加速将SiC MOSFET培育成为重要的盈利来源之一

2023年度及2024年上半年,标的公司应用于车载主驱的6英寸SiC MOSFET出货量均为国内第一,产品核心技术参数比肩国际龙头水平;2024年4月,标的公司8英寸SiC MOSFET工程批顺利下线。而上市公司的车规产品已覆盖绝大部分新能源汽车终端客户,工控产品覆盖主要风光储新能源终端客户。本次交易完成后,上市公司在SiC MOSFET产品上将形成协同效应。上市公司将集中

资金优势、技术优势、采购优势和客户优势，全方位投入资源以更好地助力碳化硅业务的快速发展，加快推动国内首条 8 英寸 SiC MOSFET 生产线建设，争取在 2025 年内提早实现量产，成为国内首家实现规模量产的 8 英寸 SiC MOSFET 企业，并使其成为公司未来重要的盈利来源之一。

综上所述，公司董事会认为，本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条的相关规定。

特此说明。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2024 年 9 月 4 日